

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

芯智控股有限公司
Smart-Core Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2166)

關連交易
提供財務資助

貸款

於2020年5月8日，芯智國際與銘冠訂立貸款協議，據此，芯智國際同意向銘冠提供總額為3,800,000美元年利率為7%的美元循環貸款融資。

上市規則涵義

於本公告日期，本公司的全資附屬公司Smart IC Cloud持有銘冠25%已發行股本。燕先生為執行董事，因而為本公司的關連人士。彼亦為銘冠的主要股東。因此，銘冠被視為上市規則第14A.27條所界定共同持有的實體。

芯智國際根據貸款協議向銘冠作出的貸款構成上市規則第14A.26條項下本公司的關連交易。由於有關貸款的最高適用百分比率(定義見上市規則)不超過5%，因此貸款協議須遵守上市規則第14A.76(2)條的申報及公告規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

由於燕先生為本公司的關連人士(如上文所披露)及李先生為銘冠的主要股東，個人擔保(燕青)及個人擔保(李紅勝)以財務資助的形式各自構成上市規則項下本公司的關連交易。根據上市規則第14A.90條，由於董事認為有關財務資助乃按一般商業條款或更佳條款進行，且並非以本集團資產作抵押，故本集團收取的有關財務資助獲全面豁免遵守上市規則第14A章的申報、公告及獨立股東批准規定。

貸款

於2020年5月8日，本公司的全資附屬公司芯智國際與銘冠訂立貸款協議，據此，芯智國際同意向銘冠提供總額為3,800,000美元年利率為7%的美元循環貸款融資。

貸款協議

日期

2020年5月8日

訂約方

- (1) 本公司的全資附屬公司芯智國際(作為貸方)；及
- (2) 銘冠(作為借方)。

標的事項

根據貸款協議，芯智國際同意向銘冠提供總額為3,800,000美元年利率為7%的美元循環貸款融資。芯智國際同意於貸款協議日期至2021年4月29日(包括該日)向銘冠提供融資，而到期日為2021年4月30日。銘冠須將所有貸款用於為銘冠客戶(「客戶」)不時向銘冠下達的訂單(「客戶訂單」)所產生的商品性質貨品電子元件採購訂單(「採購訂單」)提供融資。

提取

倘(其中包括)(i)因提供該貸款而致未償還貸款總額將超過3,800,000美元；(ii)於該貸款的適用提取要求日期或建議提取日期，貸款協議界定的違約事件正持續或將由該貸款導致；或(iii)銘冠未能提供芯智國際全權酌情認為其可信納的證據，證明適用採購訂單、適用客戶及適用客戶訂單的條款、安排、協議或其他方面已經或將會按芯智國際信納的條款訂立(包括但不限於銘冠向該客戶提供的信貸期、該客戶的信用狀況、該客戶已支付的訂金金額、所訂購貨品類型以及配對採購訂單與客戶訂單的純利)，芯智國際將毋須作出任何貸款。

於有效期限，銘冠可能於不遲於建議提取日期前兩個營業日當日上午11時正(香港時間)(或芯智國際同意的較短時間)透過向芯智國際遞交提取要求特定表格(並

具備與適用相關採購訂單及客戶訂單有關且格式及內容為芯智國際所信納的證據或文件支持及／或補充)提取貸款。銘冠可能根據貸款協議的條款再次提取貸款的任何已償還部分。

利息

每筆貸款的適用年利率將為7%，此乃參考市場現行利率釐定。

就各拖欠貸款應付的利息將於該貸款的適用還款日期支付，惟於到期日，銘冠將支付(以尚未支付者為限)根據貸款協議欠付及／或應付的所有應計但未付利息。

還款

銘冠將於適用還款日期根據貸款協議償還各貸款，惟芯智國際容許延緩付款則除外。還款或延緩付款日期概不會延至到期日後。倘銘冠給予芯智國際不少於一個營業日的事先通知，銘冠可能會提前償還全部或任何部分貸款連同提前償還款項的應計利息。

個人擔保

為保證履行擔保義務，燕先生及李先生各自於2020年5月8日分別訂立個人擔保(燕青)及個人擔保(李紅勝)，據此，燕先生及李先生各自不可撤銷及無條件地(其中包括)向芯智國際擔保各其他債務人準時履行所有擔保義務，並承諾但凡另一名債務人未有支付擔保義務到期應付的任何款項，彼將即時應要求支付有關款項，猶如其為主要債務人。

訂立貸款協議及提供財務資助的理由及裨益

由於芯智國際與銘冠所訂立日期為2019年5月28日的先前貸款協議已於2020年3月31日屆滿，銘冠仍在擴大其作為電子元件分銷商的業務營運。為確保該穩定增長將得到足夠財力支持，銘冠將需要額外現金流量撥付因其客戶下達訂單所產生的商品採購訂單。因此，於銘冠與本公司公平磋商後，本公司同意透過芯智國際訂立貸款協議及向銘冠提供財務資助以支持其業務發展。

董事(包括獨立非執行董事)認為，雖然貸款協議並非於本集團的一般及日常業務過程中訂立，但貸款協議(由本公司與銘冠公平磋商後訂立)的條款屬一般商業條款，且有關條款屬公平合理，並符合本公司及股東整體利益。

燕先生為執行董事兼銘冠的主要股東。彼被視為於貸款協議項下擬進行交易中擁有權益，並已就批准貸款協議的相關董事會決議案放棄投票。除上述者外，概無董事於貸款協議項下擬進行交易中擁有重大權益，且彼等毋須就批准貸款協議的相關董事會決議案放棄或已經放棄投票。

有關銘冠的資料

銘冠為根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司。銘冠連同其全資附屬公司蘇州酷科為領先的電子元器件分銷商。銘冠及蘇州酷科的大部分客戶位於亞洲，惟銘冠亦向跨國公司客戶提供服務及產品。銘冠的其中一項核心業務為逆向供應鏈管理服務，並在出現市場供應短缺時為其客戶提供解決方案。銘冠亦擅於通過高效、敏銳的方式處理客戶的多餘存貨，協助彼等在全球範圍內經營OEM/EMS業務。銘冠由Smart IC Cloud、燕先生、李先生、Ng Teck Yee (Jason)及倪莉分別擁有25%、22.5%、22.5%、22.5%及7.5%，而銘冠為本公司的附屬公司，原因為根據相關會計政策，銘冠的財務業績綜合併入本集團的綜合財務報表內。詳情請參閱本公司日期為2018年10月22日的公告。

有關本集團的資料

本集團為於中華人民共和國本土領先的集成電路及其他電子元器件分銷商及技術增值服務商。本集團與全球知名的電子元器件供應商保持長期及穩定的合作關係，亦擁有忠誠及多元化的客戶群。此外，本集團提供的技術支援服務亦有助本集團與供應商及客戶保持共生關係。本集團在電視產品、智能終端、光電顯示及存儲產品方面保持領先地位。芯智國際的主要業務為電子元器件貿易，並為本公司的主要附屬公司之一。

上市規則涵義

於本公告日期，本公司的全資附屬公司Smart IC Cloud持有銘冠25%已發行股本。燕先生為執行董事，因而為本公司的關連人士。彼亦為銘冠的主要股東。因此，銘冠被視為上市規則第14A.27條所界定共同持有的實體。

芯智國際根據貸款協議向銘冠作出的貸款構成上市規則第14A.26條項下本公司的關連交易。由於有關貸款的最高適用百分比率(定義見上市規則)不超過5%，因此貸款協議須遵守上市規則第14A.76(2)條的申報及公告規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

由於燕先生為本公司的關連人士(如上文所披露)及李先生為銘冠的主要股東，個人擔保(燕青)及個人擔保(李紅勝)以財務資助的形式各自構成上市規則項下本公司的關連交易。根據上市規則第14A.90條，由於董事認為有關財務資助乃按一般商業條款或更佳條款進行，且並非以本集團資產作抵押，故本集團收取的有關財務資助獲全面豁免遵守上市規則第14A章的申報、公告及獨立股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|--------|---|--|
| 「有效期限」 | 指 | 貸款協議日期至2021年4月29日(包括該日)期間 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 芯智控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：2166) |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予的涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「提取日期」 | 指 | 於有效期限內借出或將借出貸款的日期，須為營業日 |
| 「EMS」 | 指 | 電子製造服務 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「擔保義務」 | 指 | 債務人根據或有關任何財務文件(包括貸款協議、個人擔保(燕青)、個人擔保(李紅勝)以及芯智國際及銘冠指定的任何其他文件)欠付芯智國際或所產生的一切現時及未來應付款項、債務、義務及負債(於各情況下均不論是否獨立或聯合、或與其他人士共同及個別作出，亦不論為實際或可能作出，及作為當事人或擔保人或以其他身份作出) |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |

| | | |
|-------------|---|---|
| 「貸款」 | 指 | 根據貸款協議作出或將作出的貸款，或該貸款當時未償還的本金額 |
| 「貸款協議」 | 指 | 芯智國際與銘冠所訂立日期為2020年5月8日的3,800,000美元循環貸款融資協議 |
| 「到期日」 | 指 | 2021年4月30日 |
| 「李先生」 | 指 | 李紅勝，為中華人民共和國公民及銘冠的主要股東 |
| 「燕先生」 | 指 | 燕青，為新加坡共和國公民及執行董事 |
| 「OEM」 | 指 | 原始設備製造 |
| 「債務人」 | 指 | 銘冠、燕先生及李先生，各自稱為「債務人」 |
| 「個人擔保(李紅勝)」 | 指 | 李先生(作為擔保人)為芯智國際提供的個人擔保 |
| 「個人擔保(燕青)」 | 指 | 燕先生(作為擔保人)為芯智國際提供的個人擔保 |
| 「銘冠」 | 指 | 銘冠國際香港有限公司，根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司，於本公告日期由本公司持有25% |
| 「還款日期」 | 指 | 貸款的建議還款日期(即客戶結清有關客戶訂單的相關發票擬定期限(有關發票支付限期準確性待芯智國際全權酌情信納的證據或文件核實及／或支持)後七個營業日當日)，惟該還款日期不得於到期日之後 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「芯智國際」 | 指 | 芯智國際有限公司，根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司，為本公司的全資附屬公司 |

| | | |
|------------------|---|--|
| 「Smart IC Cloud」 | 指 | Smart IC Cloud Holdings Limited，根據英屬處女群島法律正式成立及有效存續的公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」 | 指 | 具有上市規則賦予的涵義 |
| 「主要股東」 | 指 | 具有上市規則賦予的涵義 |
| 「蘇州酷科」 | 指 | 蘇州酷科電子有限公司，為銘冠的全資附屬公司，及為根據中華人民共和國法律正式註冊成立及有效存續的有限公司 |
| 「美元」 | 指 | 美利堅合眾國法定貨幣美元 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
芯智控股有限公司
 董事長及執行董事
田衛東

香港，2020年5月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事田衛東先生(董事長)、黃梓良先生、劉紅兵先生及燕青先生，獨立非執行董事鄭鋼先生、湯明哲先生及王學良先生。